(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-274852

(43)公開日 平成10年(1998)10月13日

(51) Int.Cl.6

識別記号

G03F 7/039 H01L 21/027 601

FΙ

G03F 7/039

601

H01L 21/30

502R

## 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平10-12406

(22)出願日

平成10年(1998) 1月26日

(31) 優先権主張番号 特願平9-15353

(32)優先日

平9 (1997) 1 月29日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000002093

住友化学工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

(72)発明者 上谷 保則

大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住

友化学工業株式会社内

(72)発明者 藤島 浩晃

大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住

友化学工業株式会社内

(72)発明者 宮 芳子

大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住

友化学工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 久保山 隆 (外1名)

# (54) 【発明の名称】 化学増幅型ポジ型レジスト組成物

#### (57)【要約】

【課題】 樹脂成分と酸発生剤を含有する化学増幅型の ポジ型レジスト組成物であって、感度や解像度などの各 種のレジスト性能が良好であるとともに、特に基板への 接着性に優れるものを提供する。

【解決手段】 アルキルで置換されてもよいブチロラク トン残基を有する樹脂、および酸発生剤を含有する化学 増幅型ポジ型レジスト組成物。このブチロラクトン残基 は、例えばそのαー位で、エステル結合やエーテル結合 を介して樹脂基体に結合することができる。また、この 樹脂は通常さらに、酸の作用により解裂する基を有す る。

2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】アルキルで置換されてもよいブチロラクトン残基を有する樹脂、および酸発生剤を含有することを特徴とする化学増幅型ポジ型レジスト組成物。

【請求項2】該ブチロラクトン残基が、エステル結合またはエーテル結合により樹脂基体に結合している請求項 1記載の組成物。

【請求項3】該ブチロラクトン残基が、該ブチロラクトンのα-残基である請求項1または2記載の組成物。

【請求項4】該樹脂が、該ブチロラクトン残基のほかに、酸の作用により解裂する基を有する請求項1~3のいずれかに記載の組成物。

【請求項5】酸の作用により解裂する基が脂環式環を有する請求項4記載の組成物。

【請求項6】該樹脂が、該ブチロラクトン残基および酸の作用により解裂する基のほかに、脂環式環を有する請求項4または5記載の組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体の微細加工 20 に用いられる化学増幅型のポジ型レジスト組成物に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】半導体の微細加工には通常、レジスト組成物を用いたリソグラフィプロセスが採用されており、リソグラフィにおいては、レイリー(Rayleigh)の回折限界の式で表されるように、原理的には露光波長が短いほど解像度を上げることが可能である。半導体の製造に用いられるリソグラフィ用の露光光源は、波長436nmのg線、波長365nmのi線、波長248nmのKrFエ 30キシマレーザーと、年々短波長になってきており、次世代の露光光源として、波長193nmのArFエキシマレーザーが有望視されている。

【0003】ArFエキシマレーザー露光機に用いられるレンズは、従来の露光光源用のものに比べて寿命が短いので、ArFエキシマレーザー光に曝される時間はできるだけ短いことが望ましい。そのためには、レジストの感度を高める必要があることから、露光により発生する酸の触媒作用を利用し、その酸により解裂する基を有する樹脂を含有するいわゆる化学増幅型レジストが用い 40られる。

【0004】ArFエキシマレーザー露光用のレジストに用いる樹脂は、レジストの透過率を確保するために芳香環を持たず、またドライエッチング耐性を持たせるため、芳香環の代わりに脂環式環を有するものがよいことが知られている。このような樹脂としてこれまでにも、D.C. Hofer, Journal of Photopolymer Science andTechnology, Vol. 9, No. 3 (1996) 387-398 に記載されるような各種の樹脂が知られている。しかしながら、従来公知の樹脂では、特にその極性が足りない場合に、現像 50

時の接着性不足から、現像剥がれを起こしやすいという 問題がある。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、樹脂成分と酸発生剤を含有し、ArFやKrFなどのエキシマレーザーリソグラフィに適した化学増幅型のポジ型レジスト組成物であって、感度や解像度などの各種のレジスト性能が良好であるとともに、特に基板への接着性に優れるものを提供することにある。

【0006】本発明者らは、化学増幅型のポジ型レジスト組成物を構成する樹脂に、ある種の基を導入することにより、基板への接着性が改良されることを見出し、本発明を完成した。

## [0007]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、アルキルで置換されてもよいブチロラクトン残基を有する樹脂、および酸発生剤を含有してなる化学増幅型ポジ型レジスト組成物を提供するものである。

#### [8000]

【発明の実施の形態】本発明のポジ型レジスト組成物を構成する樹脂は、通常、エチレン性不飽和結合を有する化合物の重合または共重合によって得られるものであり、また芳香環を持たず、そして脂環式環を有するものが好ましい。この脂環式環は特に、脂環式炭化水素残基、それも架橋炭化水素環であるのが好ましく、例えば、ボルナン環、ノルボルナン環、トリシクロデカン環、テトラシクロドデカン環、アダマンタン環などが挙げられる。より具体的な樹脂としては、(メタ)アクリル酸の脂環式エステルから導かれる重合単位を有するもの、脂環式カルボン酸のビニルエステルまたはイソプロペニルエステルから導かれる重合単位を有するものなどを挙げることができる。

【0009】本発明では、かかる樹脂中に、ブチロラク トン残基を含有させる。ここでいうブチロラクトン残基 は、無置換であっても、またアルキルで置換されていて もよく、このアルキルは、メチル、エチル、プロピルお よびブチルのように、炭素数1~4程度であることがで きる。このブチロラクトン残基は例えば、エステル結合 やエーテル結合の形で樹脂基体に結合することができ る。ブチロラクトン残基における結合手の位置は特に限 定されないが、例えば、ブチロラクトンの $\alpha$  一位(すな わち2-位)から結合手の出ているものであることがで きる。このようなブチロラクトン残基を有する重合単位 は、その中にさらに前記した脂環式環を含むこともでき る。例えば、(メタ)アクリル酸の脂環式エステルから 導かれる単位であって、その脂環式環にブチロラクトン 残基がエステル結合またはエーテル結合しているような ものも、ここでいうブチロラクトン残基を有する重合単 位に包含される。

【0010】樹脂中にブチロラクトン残基を導入するに

は、当該樹脂中または当該樹脂を構成するモノマー中に存在するカルボン酸基やアルコール性水酸基を、ブチロラクトンエステルにしたり、ブチロラクトンエーテルにする方法が採用できる。このようなエステル化やエーテル化には、例えば、アルキルで置換されてもよいブチロラクトンのハロゲン置換体を用いることができる。ブチロラクトン残基が導入されたモノマーを用意した場合は、それを一成分として重合させればよい。このようなモノマーとしては例えば、 $\alpha$ -アクリロイロキシー $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ -メタクリロイロキシー $\gamma$ -ブチロラクトンなどが挙げられる。

【0011】化学増幅型レジスト用の樹脂は一般に、それ自体ではアルカリに不溶ないし難溶であるが、酸の作用により一部の基が解裂し、解裂後はアルカリ可溶性となるものである。そこで本発明に用いる樹脂は通常、ブチロラクトン残基のほか、酸の作用により解裂する基を有する。酸の作用により解裂する基の中に、前記した脂環式環を含むこともできる。

【0012】酸の作用により解裂する基はレジストの分 20 野で公知であり、例えば、tertーブチルのような1-位 で分岐したアルキル基;1-エトキシエチル、1-(2 ーメチルプロポキシ) エチル、1-(2-メトキシエト キシ) エチル、1-(2-アセトキシエトキシ) エチ ル、1-[2-(1-アダマンチルオキシ)エトキシ] エチルおよび1-〔2-(1-アダマンタンカルボニル オキシ)エトキシ]エチルのような、さらに置換されて もよい1-アルコキシアルキル基;テトラヒドロー2-フラニル、テトラヒドロー2-ピラニル、3-オキソシ クロヘキシル、4ーメチルテトラヒドロー2ーピロンー 30 4-イル (メバロニックラクトンから導かれる) および 2-メチル-2-アダマンチルのような、非芳香族環状 化合物の残基などが挙げられる。これらの基が、樹脂中 またはモノマー中のカルボン酸基やアルコール性水酸基 の水素に置換することになる。このような基を有するモ ノマーを用意した場合は、それを他のモノマーと共重合 させることにより、本発明で用いる樹脂が得られる。

【0013】本発明で用いる樹脂は、パターニング露光 用の放射線の種類や、酸の作用により解裂する基の種類 などによっても変動するが、一般には、ブチロラクトン 40 残基を有する重合単位を10~60モル%の範囲で含有 するのが好ましい。また、酸の作用により解裂する基を 有する重合単位は、10~90モル%の範囲にあるのが 好ましい。酸の作用により解裂する基が同時に脂環式環 を有する場合は、それとは別に脂環式環を有する重合単 位を設けなくてもよいが、脂環式環を有する重合単位 は、全体で20モル%以上存在するのが好ましい。また この樹脂は、本発明の効果を損わない範囲で、他の重合 単位、例えば遊離のカルボン酸基を有する重合単位など を含有することもできる。 50

【0014】もう一つの成分である酸発生剤は、その物質自体に、あるいはその物質を含むレジスト組成物に、光や電子線などの放射線を作用させることにより、その物質が分解して酸を発生するものである。酸発生剤から発生する酸が前記樹脂に作用して、その樹脂中に存在する酸の作用で解裂する基を解裂させることになる。このような酸発生剤には、例えば、オニウム塩化合物、有機ハロゲン化合物、スルホン化合物、スルホネート化合物などが包含される。具体的には、次のような化合物を挙げることができる。

【0015】ジフェニルヨードニウム トリフルオロメタンスルホネート、4ーメトキシフェニルフェニルヨードニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4ーメトキシフェニルフェニルヨードニウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス(4ーtertーブチルフェニル)ヨードニウム テトラフルオロボレート、ビス(4ーtertーブチルフェニル)ヨードニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ビス(4ーtertーブチルフェニル)ヨードニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ビス(4ーtertーブチルフェニル)ヨードニウム トリフルオロメタンスルホネート、

【0016】トリフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロホスフェート、トリフェニルスルホニウム ヘキサフ ルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウム ト リフルオロメタンスルホネート、4-メトキシフェニル ジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネー ト、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ト リフルオロメタンスルホネート、4-メチルフェニルジ フェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネー ト、2、4、6ートリメチルフェニルジフェニルスルホ ニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロ メタンスルホネート、4-フェニルチオフェニルジフェ ニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-フェニルチオフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサ フルオロアンチモネート、1-(2-ナフトイルメチ ヘキサフルオロアンチモネート、 ル)チオラニウム 1-(2-ナフトイルメチル) チオラニウム トリフル オロメタンスルホネート、4ーヒドロキシー1ーナフチ ルジメチルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネー ト、4-ヒドロキシー1-ナフチルジメチルスルホニウ ム トリフルオロメタンスルホネート、

【0017】2ーメチルー4,6ービス(トリクロロメチル)-1,3,5ートリアジン、2,4,6ートリス(トリクロロメチル)-1,3,5ートリアジン、2ーフェニルー4,6ービス(トリクロロメチル)-1,3,5ートリアジン、2ー(4ークロロフェニル)-4,6ービス(トリクロロメチル)-1,3,5ートリアジン、2ー(4ーメトキシフェニル)-4,6ービス(トリクロロメチル)-1,3,5ートリアジン、2ー(4

られる。

ーメトキシー1ーナフチル)ー4,6ービス(トリクロ ロメチル) ~1, 3, 5-トリアジン、2-(ベンゾ ビス (トリクロロメチル) -1, 3, 5-トリアジン、 2-(4-メトキシスチリル)-4,6-ビス(トリク  $p_1$   $p_2$   $p_3$   $p_4$   $p_4$   $p_5$   $p_6$   $p_6$   $p_7$   $p_7$ 4, 5-トリメトキシスチリル) -4, 6-ビス (トリ クロロメチル) -1, 3, 5-トリアジン、2-(3, 4-ジメトキシスチリル)-4,6-ビス(トリクロロ メチル) -1, 3, 5-トリアジン、2- (2, 4-ジ 10 メトキシスチリル) -4, 6-ビス (トリクロロメチ (1, 1) (2-1) (2-1) (2-1) (2-1) (2-1) (2-1) (2-1) (2-1) (2-1)チリル) -4, 6-ビス(トリクロロメチル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(4-ブトキシスチリル)-4,6ービス(トリクロロメチル)ー1、3、5ートリアジ ン、2-(4-ペンチルオキシスチリル)-4,6-ビ ス(トリクロロメチル)-1,3,5ートリアジン、

【0018】1-ベンゾイル-1-フェニルメチル p - トルエンスルホネート (通称ベンゾイントシレー ト)、2-ベンゾイル-2-ヒドロキシ-2-フェニル 20 エチル p-トルエンスルホネート (通称 α-メチロー ルベンゾイントシレート)、1,2,3-ベンゼントリ イル トリスメタンスルホネート、2,6-ジニトロベ ンジル p-トルエンスルホネート、2-ニトロベンジ ル p-トルエンスルホネート、4-ニトロベンジル p-トルエンスルホネート、

【0019】ジフェニル ジスルホン、ジーpートリル

ジスルホン、ビス (フェニルスルホニル) ジアゾメタ ン、ビス(4-クロロフェニルスルホニル)ジアゾメタ ン、ビス (p-トリルスルホニル) ジアゾメタン、ビス 30 (4-tert-ブチルフェニルスルホニル) ジアゾメタ ン、ビス(2,4ーキシリルスルホニル)ジアゾメタ ン、ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、 (ベンゾイル) (フェニルスルホニル) ジアゾメタン、 【0020】N-(フェニルスルホニルオキシ)スクシ ンイミド、N- (トリフルオロメチルスルホニルオキ シ) スクシンイミド、N- (トリフルオロメチルスルホ ニルオキシ) フタルイミド、N-(トリフルオロメチル スルホニルオキシ) -5-ノルボルネン-2, 3-ジカ ルボキシイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニル 40 オキシ) ナフタルイミド、N-(10-カンファースル ホニルオキシ) ナフタルイミドなど。

【0021】また、一般に化学増幅型のポジ型レジスト 組成物においては、塩基性化合物、特に塩基性含窒素有 機化合物、例えばアミン類を、クェンチャーとして添加 することにより、露光後の引き置きに伴う酸の失活によ る性能劣化を改良できることが知られており、本発明に おいても、このような塩基性化合物を配合するのが好ま しい。クェンチャーに用いられる塩基性化合物の具体的 [0022]

【0023】式中、R<sup>11</sup>、R<sup>12</sup>、R<sup>13</sup>、R<sup>14</sup>およびR<sup>15</sup> は互いに独立に、水素、水酸基で置換されてもよいアル キル、シクロアルキル、アリールまたはアルコキシを表 し、Aはアルキレン、カルボニルまたはイミノを表す。 ここで、R<sup>11</sup>~R<sup>15</sup>で表されるアルキルおよびアルコキ シは、炭素数1~6程度であることができ、シクロアル キルは、炭素数5~10程度であることができ、そして アリールは、炭素数6~10程度であることができる。 また、Aで表されるアルキレンは、炭素数1~6程度で あることができ、直鎖でも分岐していてもよい。

【0024】本発明のレジスト組成物は、その全固形分 重量を基準に、樹脂を80~99.9重量%、そして酸発 生剤を0.1~20重量%の範囲で含有するのが好まし い。また、クェンチャーとしての塩基性化合物を用いる 場合は、同じくレジスト組成物の全固形分重量を基準 に、0.0001~0.1重量%の範囲で含有するのが好ま しい。この組成物はまた、必要に応じて、増感剤、溶解 抑止剤、他の樹脂、界面活性剤、安定剤、染料など、各 種の添加物を少量含有することもできる。

【0025】本発明のレジスト組成物は通常、上記の各 成分が溶剤に溶解された状態でレジスト液となり、シリ コンウェハーなどの基体上に塗布される。ここで用いる 溶剤は、各成分を溶解し、適当な乾燥速度を有し、溶剤 が蒸発したあとに均一で平滑な塗膜を与えるものであれ ばよく、この分野で通常用いられているものであること な例としては、以下の各式で示されるようなものが挙げ 50 ができる。例えば、エチルセロソルブアセテート、メチ

ルセロソルブアセテートおよびプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートのようなグリコールエーテルエステル類、乳酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミルおよびピルビン酸エチルのようなエステル類、アセトン、メチルイソブチルケトン、2ーヘプタノンおよびシクロヘキサノンのようなケトン類、γーブチロラクトンのような環状エステル類などを挙げることができる。これらの溶剤は、それぞれ単独で、または2種以上組み合わせて用いることができる。

【0026】基体上に塗布され、乾燥されたレジスト膜 10には、パターニングのための露光処理が施され、次いで脱保護基反応を促進するための加熱処理を行ったあと、アルカリ現像液で現像される。ここで用いるアルカリ現像液は、この分野で用いられる各種のアルカリ性水溶液であることができるが、一般的には、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドや(2ーヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムヒドロキシド(通称コリン)の水溶液が用いられることが多い。

#### [0027]

【実施例】次に実施例を挙げて、本発明をさらに具体的 20 に説明するが、本発明はこれらの実施例によってなんら限定されるものではない。例中にある部は、特記ないかぎり重量基準である。

#### 【0028】合成例1(モノマーの合成)

 $\alpha$ ーブロモー $\gamma$ ーブチロラクトン100gとメタクリル酸104.4g( $\alpha$ ーブロモー $\gamma$ ーブチロラクトンに対して2.0モル倍)を仕込み、 $\alpha$ ーブロモー $\gamma$ ーブチロラクトンの3重量倍のメチルイソブチルケトンを加えて溶液とした。そこにトリエチルアミン183.6g( $\alpha$ ーブロモー $\gamma$ ーブチロラクトンに対して3.0モル倍)を滴下し、その後、室温で約10時間攪拌した。濾過後、有機層を5重量%重炭酸ナトリウム水溶液で洗浄し、続いて水洗を2回行った。有機層を濃縮して、次式で示される $\alpha$ ーメタクリロイロキシー $\gamma$ ーブチロラクトンを収率85%で得た。

## [0029]

## 【0030】合成例2(別のモノマーの合成)

1-アダマンタンカルボニルクロリド55.1gとピリジン44gを仕込み、1-アダマンタンカルボニルクロリドの2重量倍のメチルイソブチルケトンを加えて溶液とした。そこにエチレングリコールモノビニルエーテル37.2g(1-アダマンタンカルボニルクロリドに対して1.5モル倍)を滴下し、その後、室温で約10時間攪拌

10/11/10 - 2 / 4 6 5

8

した。濾過後、有機層を5重量%重炭酸ナトリウム水溶液で洗浄し、続いて水洗を2回行った。有機層を濃縮後、3重量倍の1、4ージオキサンを加えて溶液とし、そこに適量のpートルエンスルホン酸一水和物とメタクリル酸36gを仕込み、室温で約10時間攪拌した。その後、有機層を5重量%重炭酸ナトリウム水溶液で洗浄し、続いて水洗を2回行った。 この有機層を濃縮して、次式で示される1ーアダマンタンカルボン酸2ー(1ーメタクリロイロキシエトキシ)エチルを収率75%で得た。

#### [0031]

#### 【0032】合成例3 (別のモノマーの合成)

2ーメチルー2ーアダマンタノール83.1gとトリエチルアミン101gを仕込み、200gのメチルイソブチルケトンを加えて溶液とした。そこに、メタクリル酸クロリド78.4g(2ーメチルー2ーアダマンタノールに対して1.5モル倍)を滴下し、その後、室温で約10時間攪拌した。濾過後、有機層を5重量%重炭酸ナトリウム水溶液で洗浄し、続いて水洗を2回行った。有機層を濃縮したあと、減圧蒸留して、次式で示されるメタクリル酸2ーメチルー2ーアダマンチルを収率75%で得た。

## [0033]

#### 【0034】合成例4(樹脂Alの合成)

メタクリル酸1-エトキシエチル、メタクリル酸イソボルニル、および合成例1で得られたα-メタクリロイロキシーγーブチロラクトンを、5:3:2のモル比(31.6g:26.7g:13.6g)で仕込み、全モノマーの402重量倍のメチルイソブチルケトンを加えて溶液とした。そこに、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを全モノマー量に対して2モル%添加し、80℃で約8時間加熱した。その後、反応液を大量のヘプタンに注いで沈殿させる操作を2回行い、精製した。その結果、次式で示され、各単位の組成モル比が50:30:20で、重量平均分子量が約10,000の共重合体を得た。

#### [0035]

【0036】合成例5(樹脂AXの合成:比較用) メタクリル酸1-エトキシエチル、メタクリル酸イソボ ルニル、およびメタクリル酸を、5:3:2のモル比

\*成例4と同様に操作した。その結果、次式で示され、各 単位の組成モル比が50:30:20で、重量平均分子 10 量が約 10,000 の共重合体を得た。

(31.6g:26.7g:6.9g) で仕込んだほかは、合\*

[0037]

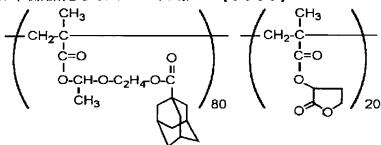
$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2}\text{-}C \\ C=O \\ O-CH-CH_{3} \\ OC_{2}H_{5} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2}\text{-}C \\ C=O \\ C=O \\ O-CH_{3} \\ OC_{2}H_{5} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2}\text{-}C \\ C=O \\ C=O \\ O-CH_{3} \\ O-CH_{3} \\ O-CH_{3} \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2}\text{-}C \\ C=O \\ O-CH_{3} \\ O-CH_{3}$$

## 【0038】合成例6(樹脂A2の合成)

合成例2で得られた1-アダマンタンカルボン酸2-(1-メタクリロイロキシエトキシ) エチルと、合成例 1 で得られた α - メタクリロイロキシ- γ - ブチロラク トンを、8:2のモル比(33.7g:4.3g)で仕込 み、全モノマーの2重量倍のメチルイソブチルケトンを 加えて溶液とした。そこに、開始剤としてアゾビスイン※ ※ブチロニトリルを全モノマー量に対して2モル%添加

20 し、80℃で約8時間加熱した。その後、反応液を大量 のヘプタンに注いで沈殿させる操作を2回行い、精製し た。その結果、次式で示され、各単位の組成モル比が8 0:20で、重量平均分子量が約 10,000 の共重合体を

[0039]



【0040】合成例7 (樹脂AYの合成:比較用) 1-アダマンタンカルボン酸2-(1-メタクリロイロ キシエトキシ) エチルとメタクリル酸を8:2のモル比

(33.7g: 2.2g) で仕込んだほかは、合成例6と同★

★様に操作した。その結果、次式で示され、各単位の組成 モル比が80:20で、重量平均分子量が約10,000の 共重合体を得た。

[0041]

## 【0042】合成例8(樹脂A3の合成)

合成例3で得られたメタクリル酸2-メチルー2-アダ マンチル、合成例2で得られた1ーアダマンタンカルボ 50 ーブチロラクトンを、3:5:2のモル比 (23.4g:

ン酸2- (1-メタクリロイロキシエトキシ) エチル、 および合成例1で得られたαーメタクリロイロキシーγ

56.2g:11.3g) で仕込み、全モノマーの2重量倍 のメチルイソブチルケトンを加えて溶液とした。 そこ に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを全モノ マー量に対して2モル%添加し、80℃で約8時間加熱 した。その後、反応液を大量のヘプタンに注いで沈殿さ\* \*せる操作を2回行い、精製した。その結果、次式で示さ れ、各単位の組成モル比が30:50:20で、重量平 均分子量が約 10,000 の共重合体を得た。

12

[0043]

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2}\text{-}C \\ C=O \\ O \\ O \end{array} \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2}\text{-}C \\ C=O \\ O-CH-OC_{2}H_{4}O-C \\ CH_{3} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2}\text{-}C \\ C=O \\ O-CH-OC_{2}H_{4}O-C \\ O \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ C=O \\ O \\ O \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ C=O \\ O \\ O \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ C=O \\ O \\ O \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ C=O \\ O \\ O \end{array} \begin{array}{c} CH_{2}\text{-}C \\ C=O \\ O \\ O \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2}\text{-}C \\ O \\ O \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_$$

## 【0044】合成例9 (樹脂AZの合成)

メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル、1-アダ マンタンカルボン酸2-(1-メタクリロイロキシエト キシ) エチルおよびメタクリル酸を、3:5:2のモル 比(23.4g:56.2g:5.7g)で仕込んだほかは、※ ※合成例8と同様に操作した。その結果、次式で示され、 各単位の組成モル比が30:50:20で、重量平均分 子量が約 10,000 の共重合体を得た。

[0045]

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_3 \\
 & CH_2 - C \\
 & C \\
 &$$

【0046】実施例1~6および比較例1~6 各例毎に、表1に示す樹脂を15部、酸発生剤としての ジフェニルジスルホン (みどり化学 (株) 製)を0.15 らをプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト60部に溶かし、さらに孔径0.2μmのフッ素樹脂製 フィルターで濾過して、レジスト液を調製した。これ を、ヘキサメチルジシラザン (HMDS) で処理したシリコ ンウェハー(水の接触角60°) または、有機反射防止 膜を塗布したシリコンウェハーに、乾燥後の膜厚が 0. 72μmとなるよう塗布した。有機反射防止膜は、Brewe r社の"XHRi-11"を、175℃、60秒のベーク条件 で、1,700Åの厚さとなるように塗布して形成させた。 レジスト液塗布後のプリベークは、90℃、60秒の条 40

【0047】こうしてレジスト膜を形成したウェハー に、KrFエキシマステッパー [(株)ニコン製の "NSR 1755 EX8A"、NA=0.45] を用いて、ラインアンドスペー スパターンを露光した。次に、ホットプレート上にて表 1に示す条件でポストエキスポジャーベーク (PEB) ★

件で、ダイレクトホットプレート上にて行った。

★を行い、さらに、2.38重量%テトラメチルアンモニウ ムヒドロキシド水溶液またはそれを純水で表1に示すよ うに希釈した現像液で、60秒間のディップ現像を行っ 部および表1に示すクェンチャーを0.01部用い、これ 30 た。現像後のパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、有 機反射防止膜基板上に設けたレジスト膜から得られたパ ターンについて、以下の方法で、感度および解像度を調 べた。

> 【0048】感度: 0.5 μmのラインアンドスペース パターンが1:1となる露光量(実効感度)で表示し た。

> 【0049】解像度: 実効感度の露光量で分離するラ インアンドスペースパターンの最小寸法で表示した。

【0050】また、有機反射防止膜を設けていない基板 上のパターンにつき、接着性の評価を行い、0.5 μmの ラインアンドスペースパターンが1:1となる露光量で 基板に接着しているものを○、剥がれているものを×と 表示した。以上の結果を、レジストの組成とともに表1 に示す。

[0051]

【表 1 】

現像液 解像度 接着性 例 No. 樹脂 クェンチャー PEB条件 実効感度 実施例1 A1 C1100℃×60秒 1/20希釈 45 mJ/cm<sup>2</sup> 0.  $35 \,\mu$  m

	13						14	
"	2	Al	C1	n	1/5 希釈	$40 \text{ mJ/cm}^2$	$0.32\mu$ m	0
H	3	A2	C2	60℃×60秒	1/5 希釈	$45 \text{ mJ/cm}^2$	0. 35 $\mu$ m	0
"	4	A2	C2	n	希釈なし	40 mJ/cm²	$0.~32~\mu$ m	0
"	5	A3	C2	70℃×60秒	1/5 希釈	65 mJ/cm²	$0.35~\mu$ m	0
H	6	АЗ	C2	II	希釈なし	50 mJ/cm <sup>2</sup>	0. 31 $\mu$ m	0
比較	例 1	AX	C1	100℃×60秒	1/20希釈	30 mJ/cm <sup>2</sup>	0. 40 и п	
		1121	0.1	100 0	27 00 117.00	o and one	υ. 40 μ m	$\circ$
"	2	AX	C1	11	1/5 希釈	25 mJ/cm <sup>2</sup>	0. 40 μ m 0. 35 μ m	×
n n	2 3		-				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	_
	_	AX	C1	"	1/5 希釈	25 mJ/cm <sup>2</sup>	$0.35\mu$ m	×
n	3	AX AY	C1 C2	" 60℃×60秒	1/5 希釈 1/5 希釈	25 mJ/cm <sup>2</sup> 30 mJ/cm <sup>2</sup>	0. 35 μ m 0. 40 μ m	×

#### 【0052】 (表1の脚注) クェンチャー

C1:N-フェニルジエタノールアミン

C2: 2, 6-ジイソプロピルアニリン

# 【0053】合成例10 (樹脂A4の合成)

メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチルおよびα-メタクリロイロキシー γ ーブチロラクトンを、50:5 0のモル比(40.0g:29.0g)で仕込み、全モノマ 20 一の2重量倍のメチルイソブチルケトンを加えて溶液と した。そこに、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリ ルを全モノマー量に対して2モル%添加し、80℃で約 8時間加熱した。その後、反応液を大量のヘプタンに注 いで沈殿させる操作を2回行い、精製した。その結果、 次式で示され、各単位の組成モル比が50:50で、重 量平均分子量が約 8,000の共重合体を得た。

#### [0054]

## 【0057】合成例12 (樹脂A6の合成)

メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル、α-メタ クリロイロキシー γ ープチロラクトンおよびメタクリル 酸1-(2-メチルプロポキシ) エチルを50:40: 10のモル比 (40.0g:23.2g:6.4g) で仕込

\*【0055】合成例11 (樹脂A5の合成)

メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル、α-メタ クリロイロキシーャーブチロラクトンおよびメタクリル 酸1-エトキシエチルを、50:40:10のモル比 (40.0g:23.2g:5.4g) で仕込み、全モノマー の2重量倍のメチルイソブチルケトンを加えて溶液とし た。そこに、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル を全モノマー量に対して2モル%添加し、80℃で約8 時間加熱した。その後、反応液を大量のヘプタンに注い で沈殿させる操作を2回行い、精製した。その結果、次 式で示され、各単位の組成モル比が50:40:10 で、重量平均分子量が約8,000の共重合体を得た。

[0056]

加えて溶液とした。そこに、開始剤としてアゾビスイソ ブチロニトリルを全モノマー量に対して2モル%添加 し、80℃で約8時間加熱した。その後、反応液を大量 のヘプタンに注いで沈殿させる操作を2回行い、精製し た。 その結果、次式で示され、各単位の組成モル比が み、全モノマーの2重量倍のメチルイソブチルケトンを 50 50:40:10で、重量平均分子量が約8,000の共重

合体を得た。

\* [0058] Ċ=O O-CH-CH<sub>3</sub>

## 【0059】合成例13 (樹脂A7の合成)

メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル、α-メタ クリロイロキシー γ ープチロラクトンおよびメタクリル 酸tert-ブチルを、50:40:10のモル比(40.0 g:23.2g:4.8g)で仕込み、全モノマーの2重量 倍のメチルイソブチルケトンを加えて溶液とした。そこ に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを全モノ※

10※マー量に対して2モル%添加し、80℃で約8時間加熱 した。その後、反応液を大量のヘプタンに注いで沈殿さ せる操作を2回行い、精製した。その結果、次式で示さ れ、各単位の組成モル比が50:40:10で、重量平 均分子量が約 8,000の共重合体を得た。

16

[0060]

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_2-C & CH_3 \\
CH_2-C & CH_2-C & CH_3 \\
C & C & CH_2-C & CH_3 \\
C & C & C & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_2-C & CH_3 \\
C & C & C & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_2-C & CH_3 \\
C & C & C & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_2-C & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_2-C & CH_3
\end{array}$$

#### 【0061】実施例7~10

各例毎に、表2に示す樹脂を15部、 酸発生剤として の4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム トリフ ルオロメタンスルホネート(みどり化学(株)製)を 0.30部、およびクェンチャーとしての2,6-ジイソ プロピルアニリンを 0.02 部用い、これらをプロピレン グリコールモノメチルエーテルアセテート70部に溶か し、さらに孔径 0.2 μmのフッ素樹脂製フィルターで濾 過して、レジスト液を調製した。これを、ヘキサメチル ジシラザン (HMDS) で処理したシリコンウェハー (水の 接触角60°)または、有機反射防止膜を塗布したシリ コンウェハーに、乾燥後の膜厚が 0.455 μmとなるよ う塗布した。有機反射防止膜は、Brewer社の "DUV-18" L" を、215℃、60秒のベーク条件で570Åの厚 さとなるように塗布して形成させた。レジスト液塗布後 のプリベークは、130℃、60秒の条件で、ダイレク 40 トホットプレート上にて行った。

【0062】こうしてレジスト膜を形成したウェハー に、KrFエキシマステッパー [(株)ニコン製の "NSR 1755 EX8A"、NA=0.45〕を用いて、ラインアンドスペー スパターンを露光した。次に、ホットプレート上にて1 20℃で60秒間のポストエキスポジャーベーク (PE B)を行い、さらに、2.38 重量%テトラメチルアンモ ニウムヒドロキシド水溶液で60秒間のディップ現像を 行った。現像後のパターンを走査型電子顕微鏡で観察 し、有機反射防止膜基板上に設けたレジスト膜から得ら 50 ストは、現像液濃度が高くても現像剥がれを起こすこと

れたパターンについて、以下の方法で、感度および解像 度を調べた。

【0063】感度:  $0.5 \mu m$ のラインアンドスペース パターンが1:1となる露光量(実効感度)で表示し

【0064】解像度: 実効感度の露光量で分離するラ インアンドスペースパターンの最小寸法で表示した。

【0065】また、有機反射防止膜を設けていない基板 上のパターンにつき、接着性の評価を行い、0.5μμの ラインアンドスペースパターンが1:1となる露光量で 基板に接着しているものを○、剥がれているものを×と 表示した。以上の結果を、レジストの組成とともに表2 に示す。

[0066]

【表 2 】

例No	).	樹脂	実効感度	解像度	接着性	
実施例7		A4	80 mJ/cm²	0. 24 μ m	0	
П	8	A5	70 mJ/cm <sup>2</sup>	$0.23\mu$ m	0	
Я	9	A6	60 mJ/cm <sup>2</sup>	0.22 μ m	0	
П	10	A7	75 mJ/cm²	0.24 μ m	0	

【0067】表1および表2に示すとおり、本発明によ り、樹脂A1、A2、A3、A4、A5、A6またはA7を用いたレジ

がなく、基板に対する接着性に優れている。また、解像度も改良されており、感度が大きく損なわれることもない。なお、実施例 $1\sim10$ で用いた組成物は、ArFエキシマレーザー露光機による露光でも、同様に優れた性能のレジストパターンを与える。

[0068]

18

【発明の効果】本発明の化学増幅型ポジ型レジスト組成物は、基板への接着性に優れており、また感度や解像度などのレジスト諸性能も良好である。したがって、この組成物は、KrFエキシマレーザーやArFエキシマレーザーなどを用いた露光に適しており、それによって高い性能のレジストパターンを与える。